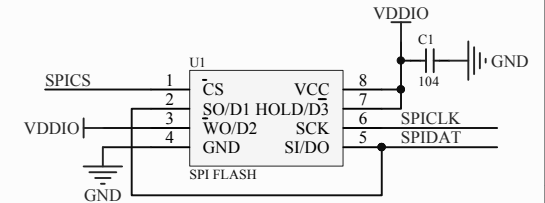
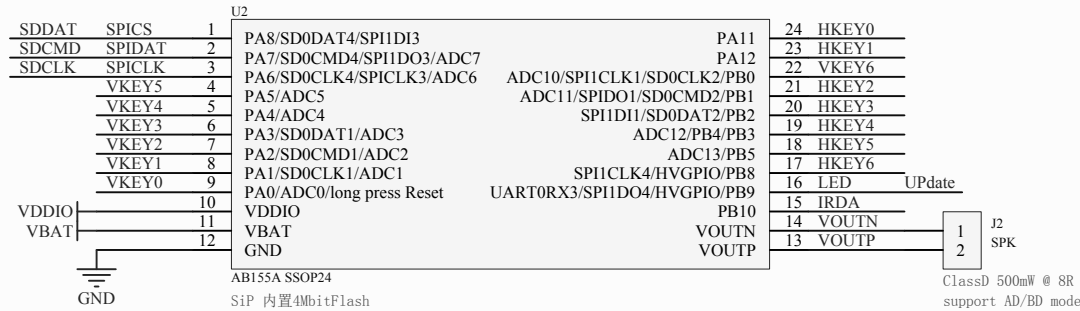


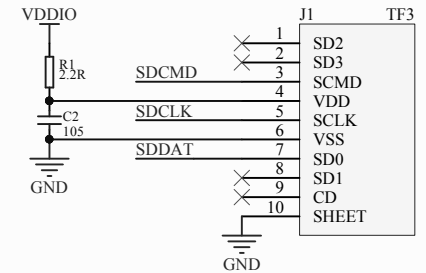
注意事项:

1. 关机模式, VDDIO电源一直有保持电压输出。
2. 芯片集成500mW@8R ClassD audioPA。
3. PA0/PB10上电默认上拉10K。PA0为长按10S拉低复位、PB10为短按拉低复位。
长按拉低复位可通过软件配置为任意PA/PB其中一个IO, 默认为PA0。
长按、短按拉低复位, 软件可屏蔽。PA0/PB10可作为普通IO使用。
PB10短按拉低复位一直拉低, 会导致上电不开机。
4. PB8/PB9/PB10/PB11 高压IO (耐5V)。
5. PB9为升级调试串口, 配合Xlink下载工具使用。
6. 红外接收信号配置到任意IO口。
7. 所有IO口可配置为唤醒口。
8. VOUTN/VOUTP 为ClassD PA输出PIN。如不用于AUDIO输出, 可做简单GPIO输出。
VOUTN/VOUTP输出1为VBAT电压, 输出0为GND。
9. 休眠有两种模式, 浅睡眠与深睡眠。
浅睡眠: RAM数据保持, 唤醒后程序原地跑, 唤醒时间短。
深睡眠: RAM数据丢失, 唤醒后程序重启跑, 唤醒时间稍长。



外挂Flash 资源

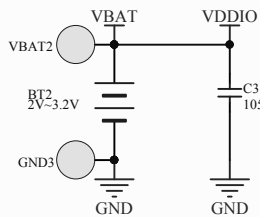
TF/FLASH二选一



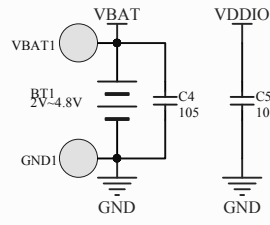
AB155A SSOP24 SCH V0.1

TF / ext Flash

2节干电池供电范围:
2V-3.2V

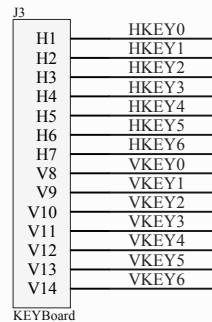


3节干电池供电范围:
2V-4.8V



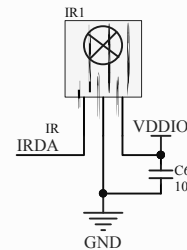
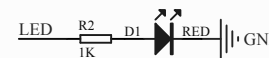
电源结构:
VBAT->内部LDO->VDDIO

POWER



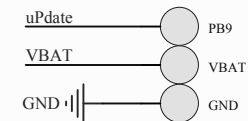
行扫描HKEY, 用普通IO口
列扫描VKEY, 用ADC功能IO口

Matix KEY



LED / IR

调试升级说明:
组1.PCBA升级testPoint预留: VBAT / GND / PB9



uPdate debug